

# 团 体 标 准

T/CWAN 0032—2021

## 软钎焊膏 分类和性能要求

Soldering paste—Classification and performance requirements

2021-12-29 发布

2022-02-01 实施

中国焊接协会 发 布

## 目 次

|                  |     |
|------------------|-----|
| 前言 .....         | III |
| 1 范围 .....       | 1   |
| 2 规范性引用文件 .....  | 1   |
| 3 术语和定义 .....    | 1   |
| 4 分类和型号 .....    | 1   |
| 5 性能要求 .....     | 2   |
| 6 标志、标签与包装 ..... | 5   |

## 前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国焊接协会提出并归口。

本文件起草单位：哈尔滨工业大学、哈尔滨焊接研究院有限公司、郑州机械研究所有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公司、苏州柯仕达电子材料有限公司、云南锡业锡材有限公司、北京康普锡威科技有限公司。

本文件主要起草人：何鹏、孙晓梅、吕晓春、钟素娟、刘伟俊、李春方、秦俊虎、张富文、林铁松、马一鸣。

# 软钎焊膏 分类和性能要求

## 1 范围

本文件规定了软钎焊膏的分类和型号、性能要求、标志、标签与包装等要求。

本文件适用于电气电子产品用软钎焊膏。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3131 锡铅钎料

GB/T 15829 软钎剂 分类与性能要求

GB/T 20422 无铅钎料

GB/T 33148 钎焊术语

T/CWAN 0031—2021 软钎焊膏试验方法

## 3 术语和定义

GB/T 33148 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 软钎焊膏 soldering paste

呈膏状的软钎料。一般由软钎料粉末、软钎剂与粘结剂混合而成。

注:以下简称焊膏。

### 3.2

#### 活性剂 activator

增加焊膏中钎剂化学反应活性的物质。

### 3.3

#### 塌陷 slump

在进行焊膏涂敷试验时,印刷在承载物上的焊膏图形发生形状变化的现象,是焊膏的一种缺陷。

## 4 分类和型号

### 4.1 分类

4.1.1 按钎料合金焊膏可分为:有铅焊膏和无铅焊膏。

4.1.2 按熔点焊膏可分为:熔点 $<178^{\circ}\text{C}$ 的低温焊膏、熔点 $\geqslant 178^{\circ}\text{C}$ 且 $\leqslant 200^{\circ}\text{C}$ 的中温焊膏、熔点 $>200^{\circ}\text{C}$ 且 $\leqslant 230^{\circ}\text{C}$ 的高温焊膏和熔点 $>230^{\circ}\text{C}$ 的超高温焊膏。

4.1.3 按卤化物含量焊膏可分为:卤化物含量 $\leqslant 0.05\%$ 的零卤焊膏,卤化物含量 $>0.05\%$ 且 $<0.5\%$ 的无卤焊膏,卤化物含量 $\geqslant 0.5\%$ 的有卤焊膏。